

International microelectronic and packaging society



Création : **19??**

Autre forme du nom : **IMAPS** (*anglais*)

International microelectronic and packaging society : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres logicielles ou multimédia (1)

"5th European advanced technology workshop on micropackaging and thermal management" (2010)

avec *International microelectronic and packaging society* comme Éditeur scientifique



Non défini (2)

"Proceeding EMPC 2013" (2015)

avec *International microelectronic and packaging society* comme Éditeur scientifique




"4th European advanced technology workshop on micropackaging and thermal management" (2009)

avec *International microelectronic and packaging society* comme Éditeur scientifique



Œuvres textuelles (1)

"Foldable flex and thinned silicon multichip packaging  technology" (2003)

avec International microelectronic and packaging society comme Éditeur scientifique

Thèmes en relation avec International microelectronic and packaging society (3 ressources dans data.bnf.fr)

Autres (3)

Circuits imprimés souples



Mise sous boîtier (microélectronique)



Modules multipuces (microélectronique)



Personnes ou collectivités en relation avec "International microelectronic and packaging society" (1 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1)

John W. Balde (1923-2003)



Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)

Notice correspondante dans Catalogue général

Sur le Web (2)

Notice correspondante dans IdRef

Notice correspondante dans VIAF